

性能特点

- 无硅体系，低挥发物
- 导热系数高，低热阻
- 耐高低温性优越，耐气候性优异
- 优异的界面润湿性
- 物理、化学性能稳定，无腐蚀性

产品描述

PAKCOOL® PC-5460 是一款高性能导热相变材料，相变温度点为 50~60℃，其室温时为橡皮泥状，可手捏或点胶成型，超过相变温度后呈硅脂状，具有优异的润湿性和压缩性。该产品是一种可返工的相变材料，应用于发热面和散热面之间的缝隙填充，能有效降低界面热阻提高散热效率，可快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

该产品除具有良好的导热性能和相变特性外，使用过程中不会有泵出、变干或渗油的问题，同时还具有导热硅脂的可靠性和易操作性。另外，此产品可添加无害的溶剂做成室温下硅脂状的产品，方便施工，用于丝网印刷等工艺。

典型应用

- 微型处理器
- IGBT
- 集成电路
- 功率转换器

注意事项

- 本产品的粘度在不同温度下有一定差异，不会影响产品使用，建议客户在恒温条件下操作。

应用指南

- 在一定压力下，涂抹后的胶层在相变温度以上会软化流动并充分地适应器件与散热器间的形状并填充细小缝隙，同时将器件与散热器间的细小气泡挤出，从而形成高效导热材料。

特性	PC-5460	测试方法
基材	无硅相变材料	--
外观	灰色橡皮泥状	目测
相变温度 (°C)	50-60°C	DSC
导热系数 (W/m*k)	≥6.0	ASTM D5470
热阻(°C-in²/W)50Psi	≤0.01	ASTM D5470
密度 (g/cm³)	2.8±0.1	ASTM D792
体积电阻率 (Ω*cm)	≥10 ¹¹	ASTM D257
保质期(@2~8°C)	12个月	--
连续使用温度 (°C)	-40~+150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

包装储运

- 本产品可提供 1Kg 罐装，5Kg 和 20Kg 的桶装，或根据客户要求定制包装。
- 本产品为无毒、不燃材料。罐/桶装产品在 2°C~8°C 下的储存期为 12 个月。产品使用前应在 25°C 或使用环境温度下回温至少 4 小时，使胶料温度与使用环境温度一致后再使用。
- 可以作为一般液体化学品运输。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。